

ELEGRIP® TAPE

概要

一般感圧タイプのダイシングテープは、各種ウエハなどの半導体のダイシング（切削）工程で使用されるテープです。多様化するニーズに対し、最適なテープを提供します。UVタイプのダイシングテープは、各種ウエハ、パッケージ基板、セラミックス、ガラス、水晶など、多様なワークのダイシング（切削）工程で使用されるテープです。紫外線を用いる事で粘着力を低減させ、剥離を容易にします。

Overview

Pressure-sensitive adhesive type is used while dicing various types of wafers. We provide the best possible tapes to meet your ever diversifying range of needs.

UV type is used while dicing a wide range of workpieces, including various types of wafers, package substrates, ceramics, glass, and crystal. For the ease of peeling, UV dicing tape is exposed to UV light, thereby weakening its adhesive strength.



ダイシングテープ（一般感圧タイプ）

Dicing Tape (pressure-sensitive adhesive type)

● 特長

- 優れた経時安定性
- 2色での品揃え：乳白、ライトブルー
- 帯電防止タイプ（オプション）

● Features

- Superior storage time stability
- Two available colors: milky white and light blue
- Anti-static types are also available (optional)

一般物性 / Physical Properties

品種 Product Number	基材 Base Film	色相 Color	総厚 Total Thickness (μm)	粘着剤厚 Adhesive Thickness (μm)	粘着力 Adhesive Strength (N/20mm)	プローブタック Probe Tack (N/20mm ²)	推奨ワーク Recommended Workpieces	備考 Remarks	
F-90MW	PO		90		0.97	0.91		脱PVC対応 PVC - free	
T-80MW	PVC	MW	80	10	0.91	0.85	シリコン (Si) ガリウム砒素 (GaAs) その他半導体	経時安定性に優れる Superior storage time stability	
T-80HW					1.84	1.29			
T-80MB					0.89	0.83			
T-80HB		LB			1.65	1.13			
					T-120HW	MW	120		1.70

備考 / 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

色相：MW(乳白)、LB(ライトブルー)

はく離ライナー(セパレータ)の厚さは含まれておりません。

Notes: The above-mentioned values are representational values only, and are not guaranteed.

Colors: MW=milky white, LB=light blue

The thickness of the release liner is not included.

ダイシングテープ (UVタイプ)

Dicing Tape (UV type)

● 特長

- 5μm～の豊富な粘着剤厚の品揃え
- 裏面チップング(クラック)やチップ飛びを低減
- イージーピックアップ(易はく離)を実現
- EMC(エポキシモールドコンパウンド)などの難接着ワークにも優れた密着性
- 帯電防止タイプ(オプション)

● Features

- Wide range of items available with different adhesive thicknesses (5μm-)
- Prevents from die-fly and chipping (cracking) on the backside surface
- Easy pickup (easy to peel)
- Exhibits superior adhesive qualities for workpieces that are incredibly anti-adhesive, such as those made from EMC (epoxy molding compounds)
- Anti-static types are available (optional)

一般物性 / Physical Properties

品種 Product number	基材 Base Film	色相 Color	総厚 Total Thickness (μm)	粘着剤厚 Adhesive Thickness (μm)	粘着力 (UV照射後) Adhesive Strength (after UV irradiation) (N/20mm)	プローブタック Probe Tack (N/20mm ²)	推奨ワーク Recommended Workpieces	備考 Remarks		
UDV-80J	PVC	T	80	10	2.64(0.10)	1.98	シリコン(Si) ガリ砒素(GaAs) その他半導体	ピックアップ性に優れる Exhibits excellent pickup		
UDV-100J			100		2.30(0.18)	2.18				
UHP-0805MC	PO	MW	85	5	3.41(0.11)	1.16	Silicon (Si), gallium arsenide (GaAs) and other types of semiconductors	裏面チップング・クラック抑制 Limits amount of chipping and cracks on the backside surface		
UHP-1005M3			105		4.39(0.10)	2.47				
UHP-0810AT			90	10	2.50(0.20)	2.10		ピックアップ性に優れる Exhibits excellent pickup		
UHP-1005AT			105	5	1.97(0.06)	1.65				
UHP-110AT			110	10	2.58(0.05)	2.27				
UHP-110BZ			110		2.83(0.05)	2.55				
UHP-110M3			110	6.54(0.09)	3.39	小チップ対応 Compatible with small-sized chips				
UHP-1025M3			125	10	11.05(0.09)	5.03			パッケージ基板 Package substrate (BGA/QFN etc)	難接着ワーク対応 Compatible with workpieces that are incredibly anti-adhesive
UHP-1510M3			160		5.86(0.10)	3.97				
USP-1510M4			160	10.64(0.13)	5.47					
UHP-1515M3	165	15	7.80(0.10)	4.42						
USP-1520MG	170	20	13.86(0.11)	6.81						
UHP-1525M3	175	25	11.49(0.09)	5.10						
UPP-0810AT	90	10	4.92(0.04)	1.80	シリコン(Si) パッケージ基板 Silicon (Si) Package substrate (BGA/QFN)	耐熱性に優れる Exhibits excellent heat-resistance				
UPP-0810W1	0.66(0.03)		0.28	加熱後のピックアップ性に優れる Exhibits excellent pickup after heated						
UDT-1005M3	PET	T	105	5	7.09(0.03)	4.36	ガラス、水晶 Glass, crystal	裏面チップング・クラック抑制 Limits the amount of chipping and cracks on the backside surface		
UDT-1025MC			125	25	28.18(0.05)	8.63				
UDT-1915MC			203	15	19.83(0.04)	3.76				

備考 / 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

色相: MW(乳白)、T(透明)

UV照射条件: 積算光量=150mJ/cm²以上

はく離ライナー(セパレータ)の厚さは含まれておりません。

Notes: The above-mentioned values are representative values only, and are not guaranteed.

Colors: MW=milky white, T=transparent

UV irradiation condition: Cumulative amount of light=150mJ/cm² or more

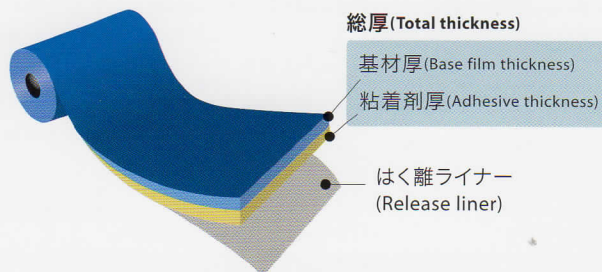
The thickness of the release liner is not included.

参考資料：粘着テープ性能表示・試験方法

Reference: How to identify and test the properties of adhesive tapes

総厚

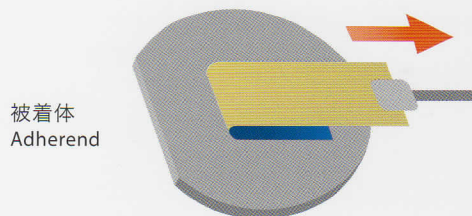
Total Thickness



総厚=基材厚+粘着剤厚
 はく離ライナー(PET:38 μ m)の厚さは含まない
 Total thickness = Base Film Thickness + Adhesive Thickness
 Release liner (PET:38 μ m) is not included.

粘着力

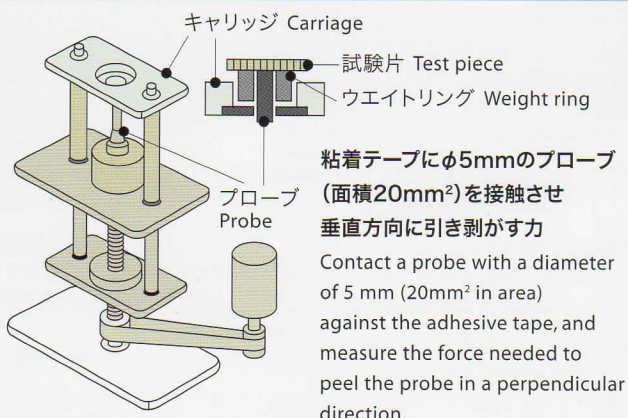
Adhesive Strength



被着体に短冊状テープを圧着させ、
 180度方向に引き剥がす力
 Press strip of tape to an adherend
 and then measure the force of 180 degree peel.

プローブタック

Probe Tack



引っ張り強さ

Tensile Strength

間隔を100mmにしたテープの両端を引っ張り、
 テープ切断時に荷重する力
 Pull both ends of a 100 mm-long tape outward,
 and then measure the force applied when the tape is cut.



伸び

Elongation

テープの両端を引っ張り、測定される伸び率
 The degree of elongation, measured when
 both ends of the tape are pulled outward.



Q

プローブタックとは何ですか？
 What is probe tack?

A.

プローブタックとは、プローブを瞬間的に粘着テープに接触させて、引き剥がす時の強度を測定する方法で、粘着表面のべたつきを評価する方法の一つです。

Probe tack is a method for measuring the stickiness of the adhesive surface. Contact the probe against the adhesive tape for a second, and then measure the force needed to remove the probe from the tape.